公司代码:688486 公司简称:龙迅股份

龙迅半导体(合肥)股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险因素,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,根据公司运营情况及未来资金使用规划,年度利润分配方案如下:

(1)向全体股东每 10 股派发现金红利 10.40 元(含税)。截至 2026 年 4 月 9 日,公司总股本 133,327,682 股,扣除回购专用证券账户中股份总数 867,474 股后的股份数为 132,460,208 股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利 137,758,616.32 元(含税)。本年度公司现金分红金额占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 80.13%。

(2)公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,不送红股。截至 2026 年 4 月 9 日,公司总股本 133,327,682 股,扣除回购专用证券账户中股份总数 867,474 股后的股份数为 132,460,208 股,以此为基数计算,共计转增 52,984,083 股,转增后公司总股本为 186,311,765 股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等变动使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变,相应调整分配的利润总额和转增的公积金总额,并将另行公告具体调整情况。

2025 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、公司存在未弥补亏损

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	龙迅股份	688486	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵彧	何冬琴
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区前松路 3963 号智能科技园 B3 栋	安徽省合肥市经济技术开发区前松路 3963 号智能科技园 B3 栋
电话	0551-68114688-8100	0551-68114688-8100
传真	0551-68114699	0551-68114699
电子信箱	yzhao@lontium.com	dqhe@lontium.com

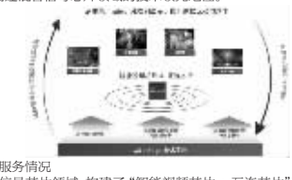
2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要业务

公司是一家专注于高速混合信号芯片研发和销售的集成电路设计企业。历经二十年的深耕积淀,公司已搭建起以高带宽 SerDes 技术、高速接口协议处理与数据加密技术、高清音视频处理与显示驱动技术等核心技术为核心的专有 ClearEdge 技术平台,形成了独有的技术壁垒与核心竞争力。依托这一成熟的专有技术平台,公司自主研发推出了一系列具备完全自主知识产权的智能视频芯片和互连芯片产品,并聚焦智能视觉终端、智能车载、AR/VR、AI&HPC 等核心领域,打造多元化、定制化的解决方案,以满足不同场景的技术应用需求。

此外,公司搭建了高效协同的产业生态合作体系,进一步为技术迭代升级赋能。一方面公司直接对接终端用户实际应用需求,快速捕捉市场技术痛点;另一方面与全球半导体领军厂商的战略合作,联动全产业链优质资源,将市场实际需求与生态协同合力,转化为核心技术持续迭代、解决方案持续优化的核心动能,让 ClearEdge 技术平台始终保持行业领先水准,实现技术研发、产品落地与市场应用的正向循环,持续巩固公司在高速混合信号芯片领域的技术领先地位。



2、公司主要产品及服务情况

公司聚焦高速混合信号芯片领域,构建了“智能视频芯片 + 互连芯片”两大产品体系,可实现数据的无缝传输和处理,并在计算、存储和显示单元之间实现高效交互。产品全面覆盖 HDMI、DP/eDP、USB-C、MIPI 等主流接口协议,支持最高 8K 超高清分辨率和最高 240Hz 高刷新率,同时,通过整合高清视频处理与显示能力以及智能感知与人机交互技术,公司的芯片在支持未来端侧 AI 应用已建立了坚实的技术基础。

智能视频芯片主要用于在终端设备中采集、连接、处理和显示视频信号,互连芯片主要用于在 CPU、GPU、存储和显示等单元之间实现高速数据互连。

(1)智能视频芯片

公司的智能视频芯片作为智能系统的视觉处理关键基础,可实现高清视觉数据的采集、连接、处理和显示,是视觉数据源端到显示端之间传输的桥梁。

公司智能视频芯片可分为视频桥接芯片与视频处理芯片:

①视频桥接芯片

公司视频桥接芯片用于将接收到的高清视频信号按协议格式进行桥接转换,并按指定格式输出至其他设备,实现高清视频信号在不同设备或协议间的兼容,可支持当前主流的高清视频协议,包括 HDMI、DP/eDP、USB-C、MIPI、LVDS、VGA 等。无论是连接笔记本电脑与 4K 投影机,或是连接车载主机与仪表,公司视频桥接芯片均可确保高带宽的视频传输,支持高达 20Gbps 的传输速率,并具备超低延迟与广泛的通讯协议兼容性。

凭借持续研发投入、精细化场景布局与严苛质量管控,针对车载、工控、消费电子、AR/VR、安防等细分场景打造定制化解决方案,公司的视频桥接芯片成功打破海外厂商长期垄断,已进入国内外多家头部终端厂商核心供应链,业务辐射欧美、东南亚等海外市场,全球市场份额与品牌认可度稳步提升。根据弗若斯特沙利文的资料,按 2024 年收入计,在视频桥接芯片市场,公司是中国内地排名第一及全球前五的公司。

②视频处理芯片

公司视频处理芯片是在视频信号桥接转换的基础上,提供强化影像处理的功能,使格式转换后的画质得以提升,并实现更佳的显示效果。作为影像品质引擎,这些芯片可提升视觉体验,而不只是简单的传输。利用公司专有的算法,公司的视频处理芯片可实现影像缩放、色彩校正和降噪等功能;并支持多视窗显示器、8K 超高清分辨率以及高达 240Hz 的高刷新率输出等,以确保呈现给人眼的最终影像清晰、流畅且色彩准确。

(2)互连芯片

互连芯片是高速信号链路中的关键接口器件,通过对信号进行放大、均衡、抖动补偿、时钟数据恢复与误码校正等处理,保证信号在高带宽与高速传输条件下的高完整性与稳定性。

公司互连芯片可分为高速信号互连芯片和 AI 运力芯片:

①高速信号互连芯片

公司高速信号互连芯片包括中继器、切换器、分配器以及矩阵芯片,可作为显示生态系统的综合信号增强器和流量控制器。运用公司专有的信号调节技术,公司高速信号互连芯片可在长距离和复杂的电路板上净化、放大和路由信号,对管理多视窗设定以及确保 AI 驱动的智能视觉终端、AR/VR 设备和智能车载显示的高保真传输极为重要。

②AI 运力芯片

公司 AI 运力芯片可支持 AI 训练和高效能运算所需的分散式拓扑。这些芯片专为 AI 服务器及终端和智能车载而设计,有助于储存单元与 CPU 和 GPU 等运算单元之间的高效数据交换。公司在研的 AI 运力芯片支持每通道高达 32Gbps 的传输速率,能确保 PCIe 4.0/5.0(兼容 CXL2.0)和 SATA 等关键接口的数据完整性。这对于在严苛环境中运行的服务器、计算集群、5G 基站和汽车电子设备的稳定性至关重要。

2.2 主要经营模式

公司自成立以来主要专注于集成电路设计和销售,采用国际集成电路设计行业广泛采用的 Fabless 模式运营。在此模式下,公司完成芯片设计后,委托晶圆代工厂及芯片封装测试公司进行生产与封测,在取得检测合格产品后,直接销售或通过经销商出售给下游客户。

芯片设计由公司的研发部、工程部和车载事业部具体负责,各部门协同合作、紧密配合,共同推进产品设计和技术研发工作。

公司芯片的生产通过委托晶圆代工厂和封装测试公司来完成。公司主要向晶圆代工厂采购晶圆制造服务,向封装测试公司采购封装测试服务。少部分产品由公司完成最后的测试环节。报告期内,公司合作的晶圆代工厂和封装测试公司主要为业内大型上市公司,经营稳定,市场知名度较高,能够按照产能和周期安排订单生产。

芯片销售环节,由于公司产品为标准化产品,下游应用领域广泛,客户群体相对分散,且部分终端客户采购芯片种类较多,更倾向于通过经销商进行集中采购。因此,公司销售模式以经销为主,直销为辅。公司采用买断式经销模式,与经销商之间发生业务往来,并为经销商销售公司产品提供必要的业务及技术培训、售前售后咨询等服务。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司主要从事高速混合信号芯片的研发设计和销售,属于集成电路设计行业。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

(2)行业发展阶段及基本特点

集成电路作为现代信息社会的核心基石,被誉为“工业粮食”,贯穿科技、经济、民生、国家安全等全领域,是支撑数字经济发展、保障国家科技安全、推动产业转型升级的关键产业。其产业链环节繁多、分工精细,形成了“设计、制造、封装、测试”四业分离的专业化格局,并衍生出 EDA 工具、IP 设计、设备、材料等配套环节,各环节关联性极强,任何一个环节的短板都将制约整个产业链的发展。公司所处的集成电路设计行业,是集成电路产业的核心前端环节,被誉为产业“大脑”,直接主导产业技术迭代方向与应用创新边界,其发展直接决定整个产业的竞争力。

当前,集成电路设计行业正处于规模持续增长、技术加速迭代、格局深刻重构的关键时期,技术多元化、产业协同化、应用全场景化、竞争全球化、发展自主化成为行业核心发展趋势。市场规模方面,伴随 AI 大模型、智能体、新能源汽车等新兴场景的爆发式需求,市场规模持续攀升,根据半导体行业协会(SIA)数据显示,2025 年全球半导体销售额创下了有史以来最高的年度销售额记录,达到 7917 亿美元,同比增长 25.6%;随着 AI、物联网、自动驾驶等新兴技术将继续推动对芯片产品的强劲需求,预计 2026 年全球销售额将达到 1 万亿美元。技术层面,行业已逐步突破传统通用设计范式的束缚,正迎向先进制程迭代攻坚的深水区;同时 Chiplet、异构集成技术也迎来规模化普及的关键阶段;此外,EDA 工具作为集成电路设计的核心支撑,正朝着人工智能驱动的智能化设计方向加速迭代升级,有望有效破解先进制程带来的物理极限约束与设计复杂度攀升等核心痛点,为行业技术进步注入新的活力。产业格局上,全球集成电路设计市场呈现“头部集聚、区域协同竞合”的格局,国际龙头企业凭借核心技术积累与完善的产业生态占据市场主导地位,中国等新兴市场正加速产业转型升级,逐步实现从“跟跑”向“并跑”的跨越式发展,国内集成电路设计企业在细分赛道持续突破,产业规模稳步攀升。根据中国半导体行业协会(CSIA)相关数据预测,2025 年中国芯片设计公司达到 3901 家,从销售规模来看,全行业销售额预计为 8357.3 亿元,相比 2024 年增长 29.4%,已成为全球集成电路产业增长的核心支撑力量。

从细分行业来看,公司所处的是混合信号芯片领域的细分赛道,正处于从“进口主导”向“国产突围”的关键阶段,既具备集成电路设计产业“技术驱动、Fabless 模式、高投入高风险高收益、政策资本赋能”的共性特点,又依托细分赛道形成了“集中度高、国产替代空间大、应用多元、产品专业化”的专属特征。市场方面,规模稳步提升,根据 Coherent Market Insights 预测,混合信号集成电路市场预计在 2025 年将达到 1405.6 亿美元,到 2032 年预计将达到 2318.3 亿美元,从 2025 年至 2032 年的复合年增长率为 7.4%;技术方面,特点鲜明、技术壁垒高,融合模拟与数字芯片技术,对研发持续投入要求极高;应用场景方面,覆盖消费电子、汽车电子、AI& 边缘计算等领域,其中车载、AI、数据中心建设成为核心增长极,供需呈现“高端产能缺口、中低端竞争激烈”的格局,高端产品主要被 TI、ADI 等国际巨头垄断,国内企业正加速高端领域突破;产业链协同紧密,上下游联动效应显著,上游 EDA 工具、晶圆制造的自主化进程逐步推进,中游设计企业需与下游终端厂商深度绑定;同时在政策扶持下,国产替代成为长期趋势,行业市场集中度持续提升,差异化、专业化成为企业生存关键。

(3)主要技术门槛

集成电路设计行业的系统复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒,对于公司聚焦的高速混合信号芯片领域,技术壁垒更为突出。首先,高速混合信号芯片的研发需同时处理模拟信号和数字信号在高速率数据传输、低延迟即时响应、稳定可靠运行以及功率效能之间达成精准平衡,这依赖研发人员对半导体物理、器件特性、噪声、寄生效应、工艺波动的深刻理解,难以用工具完全替代,需深厚的电路设计经验,这形成了天然的技术壁垒。同时,还需具备跨消费电子、汽车、工业、通讯等多应用场景的集成开发能力,研发周期长、验证流程复杂,新进入者在短期内难以开发出可量产的成熟方案。这些构成了集成电路设计行业难以逾越的综合技术壁垒,需要通过储备相应的技术经验,建立持续研发创新机制,以及拥有多年的行业应用经验,才能够在行业中立足并建立竞争优势。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

龙迅股份是一家专注于高速混合信号芯片研发、设计与销售的高新技术集成电路设计企业,采用 Fabless 轻资产运营模式,聚焦核心技术研发与产品创新,自 2006 年成立以来,始终坚持以技术创新为核心驱动力,凭借长期坚定且持续的研发投入,在高带宽 SerDes 技术、高速接口协议处理与数据加密技术、高清音视频处理与显示驱动技术等关键核心领域,积累了深厚的研发经验和雄厚的技术实力,构建了专有 ClearEdge 技术平台,形成 400 多项核心自主知识产权,相关 IP 已实现量产,无需依赖外部授权,有效降低了产品研发成本与技术风险。依托该技术平台,公司芯片产品性能持续提升,可支持最高 20Gbps 单通道传输速率,能够完美适配高清视频、高速数据传输等高端场景需求,产品全面覆盖 HDMI2.1、DP2.1、USB4、MIPI 等主流高速接口协议,视频分辨率最高支持 8K,在信号完整性、低延迟、低功耗、兼容性等关键指标上表现优异,具备与国际同类产品抗衡的实力,是国内少数能够在高速接口领域与 TI、ADI 等国际巨头直接竞争的芯片设计公司。

近年来,随着汽车电子、AIoT、AR/VR 等新兴领域的快速崛起,市场对高速混合信号芯片的需求持续爆发,公司紧抓行业发展机遇,主动调整发展战略,持续推进产品结构升级与应用场景拓展,逐步从传统消费电子领域向高附加值新兴领域延伸。在拥有核心优势的视频桥接芯片赛道,公司凭借技术积累、产品兼容性及本土化服务优势,成为该细分赛道的国内龙头企业。在汽车电子领域,公司积极布局车载高速互连相关产品,加大车载芯片研发投入,技术突破成效显著,截至 2025 年 12 月 31 日,已有 19 颗车规级芯片通过 AEC-Q100 认证(含 Grade 2 级高端产品),涵盖车载桥接芯片、车载 SerDes 芯片组等核心产品,其中车载 SerDes 芯片组(单通道 8.1Gbps)针对车载视频长距离传输需求完成技术优化,进入全面市场推广阶段。受益于车载业务的快速放量,公司车载高速互连业务收入占比显著提升,已成为公司新的核心增长点,同时已形成“龙头车企 + 新势力 +Tier 1”的全生态覆盖,进一步巩固了在车载高速混合信号芯片领域的竞争力。在国产替代加速推进的行业背景下,公司凭借深厚的技术积累、高性价比的产品及高效的本土化服务优势,成为视频桥接、车载 SerDes 等细分领域国产替代的标杆企业,有效推动了国内高速混合信号芯片产业的自主化发展,助力我国半导体产业突破海外技术封锁。同时,公司积极布局 AI、高性能计算、端侧计算等前沿领域,聚焦上述场景的高速传输芯片研发,相关部分产品已实现落地,逐步形成了“核心业务稳固、新兴业务爆发、前沿业务布局”的多元化业务格局,有效分散了市场风险,拓宽了增长空间。

当前,在国产替代与下游场景智能化升级的双重驱动下,公司正加速实现战略转型,从高清视频桥接芯片细分赛道龙头,向覆盖智能车载、智能穿戴、人工智能等多领域的中高端高速混合信号芯片优质供应商全面突破,通过持续的技术创新、场景拓展与全球化布局,不断提升核心竞争力,努力实现从国内领先向全球知名芯片设计企业的跨越。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

AI 作为引领新一轮科技革命与产业变革的核心驱动力,正深刻推动信息技术体系实现全方位演进,同时重塑各类智能系统的架构逻辑与功能形态。AI 技术的持续突破,离不开算力、算法与数据三大核心要素的协同赋能,三大要素相互支撑、协同发力,推动 AI 技术不断突破应用边界,其应用场景已从传统互联网领域,逐步延伸至工业、交通、医疗、消费电子等国民经济各关键领域。随着边缘计算、模型压缩与能效优化等配套技术的快速成熟,AI 应用重心正逐步从集中式云端向分布式终端延伸,逐步构建起“云端统筹、边缘协同、终端执行”的云边端协同体系。终端设备与云侧、边缘侧实现实时高效通信,通过任务分流、模型协同与数据共享形成高效算力互补,支撑流畅的智能化工作流程。其中,云端承担大规模 AI 模型训练与全局调度职责,边缘侧实现数据就近预处理与局部推理,终端侧聚焦数据采集、本地轻量化推理与用户交互反馈。这一全链路协同的实现,核心依赖智能视频芯片与互连芯片的底层支撑——缺乏终端侧高效的视觉处理与高速数据传输能力,分布式、场景化、实时化的智能形态便无从谈起,两类芯片更是推动智能化进程深度渗透各类终端设备、实现智能服务触手可及的核心前提。

智能视频芯片作为终端视觉处理的“核心引擎”,是终端实现 AI 视觉交互的基础,承担复杂信号处理、图像渲染、视频编解码等核心任务,直接决定 AI 生成内容与视觉输出的同步性、清晰度及低延迟性能,缺乏其支撑,终端设备无法呈现高质量智能视觉体验;互连芯片作为算力与数据传输的“核心桥梁”,是端边云协同的“生命线”,赋能端边云之间及终端内部的高速数据交互与动态算力分配,破解算力调度与数据流通的核心瓶颈,失去其赋能,云端、边缘侧与终端的协同将彻底脱节。两者分别决定终端智能的“视觉呈现质量”与端边云协同的“交互响应效率”,共同构成智能生态不可或缺的核心基础设施。

随着 AI 能力加速渗透各类终端设备,高需求领域终端设备正经历从功能型向智能型架构的系统性转型,其核心逻辑从“被动执行指令”升级为“主动感知、智能分析、实时反馈”,而这一转型的核心支撑正是智能视频芯片与互连芯片。视觉识别、语音交互、多模态融合交互等技术的持续升级,终端设备逐步摆脱传统工具属性,向智能节点演进:汽车领域的 ADAS 高级辅助驾驶、智慧座舱,依赖智能视频芯片实现实时视觉感知与图像渲染,依托互连芯片实现车载各模块的高速数据交互;AI 服务器的算力调度、大模型推理,离不开互连芯片的高速数据传输支撑;智能手机、PC 的 AI 摄影、本地推理功能,核心依赖智能视频芯片的视觉处理能力;工业终端的自动化监测与智能调控,需两类芯片协同保障数据传输与视觉反馈效率。各类终端产品能够全面迈入 AI 赋能时代,是两类芯片持续赋能的结果。

与此同时,在 AI 技术的深度赋能下,各类新兴应用场景迎来爆发式发展,而这些场景的落地与升级,依赖智能视频芯片与互连芯片的核心支撑,两类芯片更是新兴场景智能化落地的“关键基石”。AR/VR 领域的沉浸式体验,核心依赖智能视频芯片的实时渲染与高清晰度处理能力,互连芯片则保障虚拟与现实数据的高速传输,二者协同实现虚拟与现实的精准融合;新型显示系统的多屏协同、柔性显示创新,需智能视频芯片优化视觉输出效果,互连芯片保障多屏数据的高速同步交互;机器人与具身智能的多模态感知、协同交互,既离不开智能视频芯片的视觉数据处理支撑,更依赖互连芯片实现各模块的高速算力调度与数据传输。而这些新兴场景的智能化升级,终端产品渗透率与市场规模持续提升,高需求领域转型对两类芯片的性能、稳定性提出更高标准,新兴场景落地则直接拉动其需求升级。二者不仅是场景落地的核心支撑,更成为推动场景智能化升级的核心动力。

综上,无论是高需求领域转型还是新兴场景落地,两类芯片都是不可或缺的核心载体,既迎来广阔市场增长机会,更持续巩固其在智能生态中的核心支撑地位,成为 AI 驱动信息技术演进的核心底层力量。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,658,009,876.29	1,502,359,846.45	10.36	1,486,536,902.57
归属于上市公司股东的净资产	1,559,490,474.21	1,431,799,478.55	8.92	1,429,466,358.91
营业收入	568,203,739.71	466,002,733.23	21.93	323,147,354.00
利润总额	174,673,924.85	152,946,961.67	14.21	105,216,886.39
归属于上市公司股东的净利润	171,915,593.75	144,411,417.58	19.05	102,695,394.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,450,810.41	111,425,364.58	29.64	66,801,676.10
经营活动产生的现金流量净额	112,413,955.79	116,888,052.59	-3.83	103,412,018.58
加权平均净资产收益率(%)	11.66	10.22	增加 1.44 个百分点	8.45
基本每股收益(元/股)	1.30	1.09	19.27	0.79
稀释每股收益(元/股)	1.30	1.09	19.27	0.79
研发投入占营业收入的比例(%)	19.93	21.45	减少 1.52 个百分点	23.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	109,010,800.10	137,965,010.37	142,227,078.30	179,000,850.94
归属于上市公司股东的净利润	28,509,151.76	43,011,301.88	52,987,587.79	47,407,552.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,128,346.00	35,769,357.00	46,498,900.56	41,054,206.86
经营活动产生的现金流量净额	18,013,653.10	33,462,260.21	18,890,000.94	42,048,041.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,796
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,080
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
FENG CHEN	11,548,510	50,043,545	37.53	49,923,728	无		境外自然人
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	4,333,049	6,372,208	4.78		无		其他
安徽红土创业投资有限公司	604,533	5,718,562	4.29		无		境内非国有法人
合肥赛富合元创业投资中心(有限合伙)	37,085	5,378,035	4.03		无		其他
邱成英	1,060,908	4,597,266	3.45	4,597,266	无		境内自然人
合肥芯时富信息技术中心(普通合伙)	1,018,471	4,413,374	3.31	4,413,374	无		其他
合肥海恒控股集团有限公司	896,581	3,880,852	2.91		无		国有法人
全国社保基金一四组合	335,082	2,748,741	2.06		无		其他
合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙)	-697,434	2,483,014	1.86		无		其他
中国银行股份有限公司-泰信中小盘精选股票型证券投资基金	510,000	1,930,000	1.45		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	FENG CHEN 持有合肥芯时富信息技术中心(普通合伙)1.25%合伙企业财产份额并为执行事务合伙人;邱成英系 FENG CHEN 母亲;合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙)和滁州中安创投新兴产业基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,执行事务合伙人和私募基金管理人均为安徽云松创业投资基金管理有限公司;合肥海恒控股集团有限公司持有合肥赛富合元创业投资中心(有限合伙)19.96%的合伙企业财产份额,同时,合肥海恒控股集团有限公司持有合肥中安海创创业投资合伙企业(有限合伙)26.53%的合伙企业财产份额。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

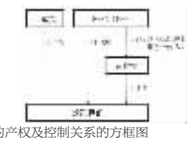
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 56,820.37 万元,实现归属于母公司所有者的净利润 17,191.56 万元。报告期末,公司总资产为 165,800.99 万元,归属于母公司的所有者权益为 155,949.05 万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2026-020

龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 限制性股票拟归属数量:400,753 股,约占公司股本总额的 0.30%,其中首次授予第二个归属期拟归属 336,406 股,预留授予第一个归属期拟归属 64,347 股

● 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”或“龙迅股份”)于 2026 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,本次符合归属条件的激励对象共计 189 人,可申请归属的第二类限制性股票数量为 400,753 股,约占公司股本总额的 0.30%,其中首次授予第二个归属期符合归属条件的激励对象 122 人,可申请归属第二类限制性股票数量 336,406 股,预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象 90 人,可申请归属第二类限制性股票数量 64,347 股。现对有关事项说明如下:

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序

公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第十五次会议及于 2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。本激励计划主要内容如下:

1、本次激励计划主要内容

(1)本激励计划的激励工具及股票来源

本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票及第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。

(2)授予的限制性股票数量(调整前)

本激励计划拟授予的限制性股票数量 138.52 万股,占《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本激励计划草案”)公告时公司股本总额 6,925.8862 万股的 2.00%。其中首次授予 123.67 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.79%,占本激励计划拟授予权益总额的 89.28%;预留 14.85 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.21%,占本激励计划拟授予权益总额的 10.72%,预留部分未超过本激励计划拟授予权益总额的 20%。

其中,第一类限制性股票授予总量为 0.60 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.01%,占本激励计划拟授出权益总数的 0.43%,未设置预留权益;第二类限制性股票授予总量为 137.92 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.99%,占本激励计划拟授出权益总数的 99.57%,首次授予 123.07 万股,占拟授予第二类限制性股票总量的 89.23%;预留 14.85 万股,占拟授予第二类限制性股票总量的 10.77%。

(3)授予价格(调整前)

本激励计划的第一类限制性股票授予价格为 70.00 元/股,首次授予的第二类限制性股票授予价格为 70.00 元/股,预留授予的第二类限制性股票授予价格为 55.00 元/股。

(4)激励对象的范围及分配情况(调整前)

本激励计划激励对象为在公司(含合并报表分子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工。

①第一类限制性股票分配情况及数量

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授予权益总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
1	苏进	中国	董事、副总经理、核心技术人员	0.60	0.43%	0.01%
合计				0.60	0.43%	0.01%

注:1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。

2、参与本激励计划的激励对象包括中国台湾地区员工,不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

②第二类限制性股票分配情况及数量

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授予权益总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
一、高级管理人员、核心技术人员及中国台湾地区员工						
1	韦永祥	中国	财务负责人	1.00	0.72%	0.01%
2	赵彧	中国	董事会秘书	1.00	0.72%	0.01%
3	夏洪锋	中国	核心技术人员	0.60	0.43%	0.01%
4	林浩原	中国台湾地区	北方海外销售总监	0.90	0.65%	0.01%
5	陈蔚元	中国台湾地区	FAE 工程师	0.60	0.43%	0.01%
董事会认为需要激励的其他员工(126 人)				118.97	85.89%	1.72%
首次授予部分合计(131 人)				123.07	88.85%	1.78%
预留部分				14.85	10.72%	0.21%
合计				137.92	99.57%	1.99%

注:1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。

2、参与本激励计划的激励对象包括中国台湾地区员工,不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

(5)本次激励计划的解除限售/归属安排

①第一类限制性股票激励计划的解除限售安排

本激励计划第一类限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

②第二类限制性股票激励计划的归属安排

本激励计划首次授予的第二类限制性股票的各批次归属比例及安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自限制性股票相应授予之日起 12 个月后的首个交易日至限制性股票相应授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自限制性股票相应授予之日起 24 个月后的首个交易日至限制性股票相应授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自限制性股票相应授予之日起 36 个月后的首个交易日至限制性股票相应授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

本激励计划预留授予的第二类限制性股票的各批次归属比例及安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自限制性股票相应授